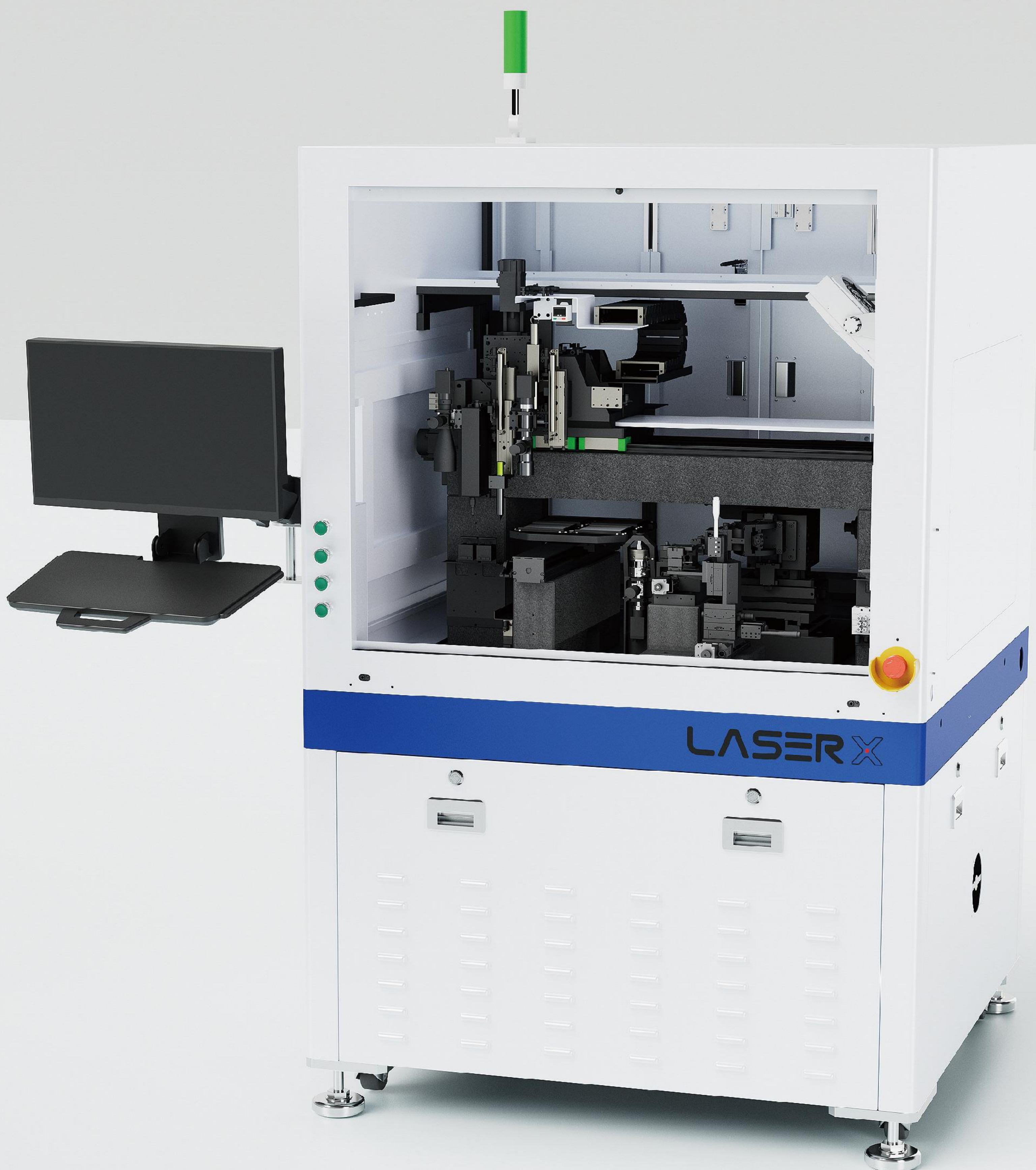


LASER X



芯片耦合测试机

产品特性	
项目	指标 / 特点
产品	支持硅光，薄膜铌酸锂
	蓝膜，单DIE，Bar条
上下料方式	全自动上下料
温度范围	25℃~80℃
升温时间(25℃~80℃)	1.5分钟
降温时间(80℃~25℃)	1.5分钟
耦合指标	光学耦合<30s（U Loop）
	耦合重复精度 < 0.2dB
	光功率稳定性 < 0.2dB@3min
耦合方式	单/双FA耦合，端面耦合，垂直耦合
设备功能	高精度扎针系统，自动扎针
	直线电机耦合系统，全自动耦合
	自动点光学胶
	自动清针
	自动分Bin
	OCR识别
	MES对接和数据自动上传